

## 삼성전자 2023년 2분기 컨퍼런스 콜

반갑습니다. 삼성전자 IR 팀장 서병훈 부사장입니다.

2023년 2분기 실적발표 컨퍼런스 콜에 참가해 주셔서 감사드립니다.

분기실적 관련 상세 내용은 실적발표 설명 자료에 있으며, IR 홈페이지 [www.samsung.com/sec/ir](http://www.samsung.com/sec/ir)에서 확인 가능합니다.

오늘 컨퍼런스 콜에는 저와 함께 각 사업을 대표하여, 메모리 김재준 부사장, 시스템LSI 권혁만 상무, 파운드리 정기봉 부사장, 삼성디스플레이, Presentation에서는 Display라 칭하겠습니다, 최권영 부사장, MX 다니엘 아라우호 상무, VD 노경래 상무가 참석하셨습니다.

참고로 본 컨퍼런스콜 내용에는 현시점 기준의 "예측정보"가 포함되어 있으며, 거시경제 및 시장상황 등의 변화에 따라 실제 경영실적과 중대한 차이가 발생할 수 있음을 알려 드립니다.

먼저, 2분기 실적에 대해 말씀 드리겠습니다.

전사 매출은 DS 부문 매출 일부 회복에도 불구하고, 스마트폰 출하 감소 등 영향으로 전분기 대비 5.9% 감소한 60조원을 기록했습니다.

매출총이익은 메모리 재고평가손 감소 및 고부가 중심 판매 등으로 전분기 대비 0.6조원 증가한 18.4조원을 기록했고, 매출총이익률도 2.8%p 증가한 30.6%를 기록했습니다.

판매관리비는 매출 감소 가운데 적극적인 연구개발 투자 등으로 전분기 대비 0.6조원 증가한 17.7조원을 기록했고, 매출 대비 비중도 2.7%p 증가한 29.5%를 기록했습니다.

어려운 경영 여건 가운데서도 연구개발비는 3개 분기 연속 분기 최대치를 기록하는 등 미래 성장을 위한 준비를 지속했습니다.

영업이익의 경우 스마트폰 출하 감소에도 불구하고, DS 적자폭 축소 및 디스플레이와 생활가전 수익성 개선 등으로 전분기 대비 소폭 증가한 0.7조원을 기록했습니다.

사업 부문별 실적은 DS, 디스플레이, DX 주요 내용을 설명 드리고, 사업별 스피치에서 커버되지 않는 네트워크, 생활가전, 하만도 더불어 말씀 드리겠습니다.

DS 부문은 메모리의 경우 HBM/DDR5 중심 AI向 수요 강세 대응을 통한 DRAM 출하량 가이던스 상회 속에 전분기 대비 실적이 개선되었으나, 시스템반도체는 주요 응용처 수요 부진 속에 가동률 하락으로 이익이 감소했습니다.

디스플레이는 중소형의 경우 계절적 비수기임에도 견조한 프리미엄向 패널 판매로 전분기 수준의 이익을 기록했습니다. 대형은 프리미엄 시장내 QD-OLED 입지 강화에 지속 중점을 두었습니다.

DX 부문은 수요 약세 가운데서도 TV/가전 프리미엄 제품 판매 확대, 원가구조 개선, 프로세스 효율화 등으로 견조한 수익성을 달성했습니다.

네트워크는 북미/일본 등 주요 해외시장 매출이 감소했습니다.

생활가전은 계절적 성수기 가운데 프리미엄 제품 판매 확대 및 물류비 등 비용 절감으로 수익성이 개선되었습니다.

하반은 포터블/TWS 중심 소비자 오디오 수요 증가와 제반비용 관리 등으로 매출과 이익 모두 증가했으며, 역대 최대 규모의 전장 사업 수주를 달성하며 성장 기반을 공고히 했습니다.

환경향과 관련하여 2분기에 원화가 달러화 유로화, 주요

이미징 통화 등 대비 약세를 나타냈습니다. 이에 따라 부품과 세트사업 전반에 걸쳐 전분기 대비 전사 영업이익에 긍정적 효과가 있었습니다.

다음으로, 하반기 전망에 대해 말씀드리겠습니다.

하반기는 글로벌 IT 수요와 업황이 점진 회복될 것으로 기대되는 가운데, 부품사업 중심으로 상반기 대비 전사 실적 개선이 예상됩니다.

다만, 매크로 리스크 등으로 인한 수요회복 관련 불확실성은 지속될 것으로 보입니다.

DS부문은 업계 재고조정 마무리 등 점진적인 수요 회복 전망 가운데 DDR5, LPDDR5x, HBM3 등 고부가 제품 판매와 신규 수주 확대를 추진하면서 인프라, R&D, 패키징 투자 지속과 GAA 공정 완성도 향상 등 중장기 경쟁력 강화와 성장 기반 확보 노력도 지속할 것입니다.

다만, Legacy 제품 중심 재고조정 지속 가능성에 대한 관측이 필요해 보입니다.

디스플레이는 중소형의 경우 스마트폰 주요 고객 신제품 출시 대응을 통해 실적이 개선될 것으로 예상됩니다. 대형은 초대형 패널 증량 등으로 연말 성수기에 적극 대응할 예정입니다.

DX부문은 폴더블/웨어러블 등 주요 신제품의 성공적 출시와 TV/가전 프리미엄 판매 확대 등을 통해 견조한 수익성을 유지하고자 합니다.

네트워크는 신규 수주 노력을 지속하는 가운데 매출 성장을 추진하고 5G 핵심칩, S/W 기반 가상화 기지국 기술 리더십을 강화하겠습니다.

생활가전은 SmartThings 기반 Energy Saving 등 친환경, 고효율 제품 판매 확대 가운데, Bespoke 글로벌 확산과 운영 효율화를 지속하겠습니다.

하만은 소비자 오디오 성수기 확판 추진 가운데, 재료비, 물류비 등 제반 비용 효율화 지속을 통해 수익성이 개선될 전망입니다.

다음으로, 시설투자에 대해 말씀 드리겠습니다.

2분기 시설투자는 14.5조원이며, 사업별로는 DS부문 13.5조원, 디스플레이 0.6조원 수준입니다. 상반기 누계로는 25.3조원이 집행되었으며, DS부문 23.2조원, 디스플레이 0.9조원 수준입니다.

지난 분기와 유사하게 메모리의 경우 중장기 공급성 확보를

위한 평택 3기 마감, 4기 골조 투자 및 선단공정 수요 대응 목적의 평택 중심 설비 투자 진행했습니다. 또한, 미래 경쟁력 강화를 위한 R&D 및 Back-end 투자도 지속했습니다.

파운드리는 선단공정 수요 대응을 위한 미국 텍사스 테일러 및 평택 중심 투자를 지속하였고, Display는 중소형 모듈 보완 및 인프라 투자가 집행되었습니다.

다음으로, 2분기 배당에 대해 말씀 드리겠습니다.

오늘 이사회는 보통주 및 우선주에 대해 주당 361원의 2분기 배당을 결의했습니다.

현재 주주환원 정책상 연간 배당금액에 따라 2분기 배당총액은 2.45조원이며, 8월 중순경에 지급될 예정입니다.

마지막으로, ESG 관련 지난 6월에 발간된 2023년 지속가능경영 보고서의 주요 내용을 간략하게 설명 드리겠습니다.

환경 분야에 있어서, DX부문은 국내 전 사업장과 베트남·인도·브라질 제조사업장에서 100% 재생에너지 사용을 달성했고, 자원순환성 강화를 위해 재생레진 적용 플라스틱 사용량을 3배 확대했습니다.

또한, DS부문은 공정가스 통합처리시설인 RCS를 지속 확대하고 공정가스 사용량을 저감했습니다.

이러한 노력을 통해 전사적으로 온실가스 1,016만톤을

감축하였고, 재생에너지 전환율 31%를 달성했습니다.

인권경영 측면에서 회사는 지난 2월 국제기준에 기반한 글로벌 인권기본원칙을 수립하여 발표했으며, 글로벌 지속가능경영 평가 단체인 World Benchmarking Alliance가 주관하는 글로벌 기업의 인권경영 수준 평가인 '기업인권벤치마크'의 최근 평가에서 ICT 제조기업 중 2위를 기록했습니다.

보다 세부적인 내용은 지속가능경영 홈페이지와 공시 시스템에 공개된 보고서를 통해 확인하실 수 있습니다.

그럼 지금부터 각 사업부문의 임원 분들께서 해당 사업부의 2분기 실적과 향후 전망에 대해 설명 드리도록 하겠습니다.

안녕하십니까,  
메모리 사업부 전략마케팅실장 김재준입니다.

2분기 메모리 수요는 응용별로 다소 다른 양상을 보였습니다. 서버의 경우, Generative AI향 수요 강세로 인해 제한된 CAPEX 내 AI 서버로 데이터센터 업체들의 투자가 집중되었습니다. 따라서, 일반 서버 및 스토리지 수요는 상대적으로 제한적이었습니다.

특히, 서버 고객사의 재고 조정 지속으로 전반적인 구매 수요는 아직 회복되지 않는 모습을 보였습니다.

반면, 당초 예상과 같이 고객사 재고 조정이 상당수준 진행된 PC와 모바일 등 소비자향 응용은 수요가 상대적으로 안정적인 흐름을 보였습니다.

이러한 상황 속, 당사는 DRAM/NAND 공히 제한적인 가격 하락폭에도 Bit Growth 가이던스를 달성하였습니다. 결과적으로, 전분기 대비 실적도 개선되었고, 재고 역시 DRAM/NAND 공히 5월에 피크아웃을 확인하였습니다.

제품별로 짚어보자면, DRAM의 경우 서버 중심 확판과 더불어 컨슈머, 그래픽, 전장향 응용에서의 판매 확대로 가이던스를 상회하는 Bit Growth 를 달성하였습니다.

특히, 서버 응용의 경우 DDR5 및 Generative AI향 HBM 수요 증가에 적극 대응하는 한편, 전반적인 판매 확대를 통해 업계의 Bit 성장을 상회하는 수준의 서버향 판매를 기록한 것으로 분석됩니다.

NAND의 경우, 선단공정 비중을 확대하며 원가경쟁력을 지속 강화하는 가운데, UFS 4.0 경쟁력과 함께 Flagship 스마트폰향 수요에 적극 대응하였습니다.

또한, 게임기기, Retail향 Branded 제품 등의 판매 확대로 Bit Growth 가이던스를 달성하였습니다.

동시에, 가격은 전분기 10% 후반의 하락폭 대비 상당히 완화된 한 자리 수 중/후반 수준의 하락폭을 기록하였습니다.

다음으로 하반기 시장 전망에 대해 말씀드리겠습니다.

업계 내 감산 기조가 증가하고 있는 가운데, 고객사 재고 조정이 일단락되면 올 하반기에는 시황이 점차 안정화될 것으로 전망됩니다.

특히 모바일과 PC에서, 주요 고객사의 Set 재고수준 정상화와 함께 하반기 스마트폰 신제품 출시와 PC 프로모션 등으로 Set Build 수요 개선이 기대됩니다.

이와 더불어 메모리 측면에서는, 가격탄력성에 기반한 고용량화가 지속 이어질 것으로 전망됩니다.

서버의 경우, 고객사 재고 조정이 모바일과 PC대비 비교적 늦게 시작되었지만, 하반기에는 재고 소진이 상당 부분 진행될 것으로 예상됩니다.

이에, 서버 수요는 점진적으로 회복될 것으로 전망되며, 제품별로는 DDR5뿐만 아니라 DDR4 제품 수요도 점차 개선될 것으로 보입니다.

이처럼 하반기 메모리 시황은 점진적으로 회복 예상되나, 여러 매크로 변수들에 따라 시황 반등의 속도는 일부 달라질 수 있을 것으로 예상됩니다.

이에 당사는 하반기 시황과 연계된 유연한 공급을 바탕으로, 포트폴리오를 고부가가치/고용량 제품 중심으로 최적화해 나갈 것입니다.

특히 고성능 서버 및 모바일 Flagship 세그먼트에서의 리더십 강화를 위해, DRAM에서는 DDR5, LPDDR5x 및 HBM 등 선단 제품의 비중 확대를 가속화하고, NAND에서도 V7/V8 등 선단 공정 비중을 확대하는 가운데 서버향 PCIe Gen5, Flagship 모바일향 UFS 4.0등 신규 Interface 수요에 적극 대응할 예정입니다.  
감사합니다.

안녕하십니까, 시스템LSI사업부 권혁만 상무입니다.

2분기는 경기침체 및 인플레이션 영향 아래 가격 민감도가 낮은 프리미엄 스마트폰 수요는 견조하였으나, 그 외 세그먼트의 부진이 지속 되었습니다. 이에 따른 반도체 수요 회복 지연이 있었으며, 고객사의 재고 조정 영향으로 실적 개선이 부진하였습니다.

위와 같은 어려운 상황 속에서도 차량용 SoC는 국내 OEM사의 '25년 프리미엄 모델향에 대한 Design-award를 받았으며, 유럽 고객사와 중장기 협력을 위한 논의를 활발하게 진행하는 등으로 SoC 응용처 확대 및 사업 경쟁력 강화를 위한 노력을 지속하였습니다. 또한 Security는 지문인증카드, Power는 BMS분야로 응용처를 확대하며 다양한 사업 기반 구축 중입니다.

하반기는 인플레이션/고금리 등에 따른 소비심리 위축 및 기대 이하의 중국 리오프닝 영향 등으로 모바일 등 주요 응용처 수요 회복이 지연되고 있으나, 현재 고객사 재고 조정이 마무리 단계에 있어 IT 성수기 진입에 따른 SoC/DDI 등 부품 수요 회복으로 실적 개선을 기대하고 있습니다.

그리고 모바일 SoC는 주요 고객사의 Flagship 모델향으로 재진입을 위해 최대 성능을 확보하는 방향으로 제품 개발

중이며, 스마트폰 외 신사업 솔루션 확보 및 협력 관계 강화 노력은 지속할 예정입니다. 또한 차량용 SoC는 유럽 OEM의 '26년 과제 수주를 통해 응용처 다변화 지속 추진 예정입니다.

감사합니다.

안녕하십니까, 파운드리사업부 정기봉 부사장입니다.

2분기 매출은 전 분기 대비 증가했지만 전년 동기 대비 감소했습니다. 이러한 추세는 글로벌 경제 상황과 고객의 지속적인 재고 조정에 영향을 받아 모바일 및 소비자 제품과 같은 주요 응용처에 대한 수요를 약화시켰습니다.

매출이익률은 주로 팹 확장으로 인한 낮은 가동률과 단기 수요의 예상되는 불확실성을 반영하여 상당한 어려움에 직면했습니다.

당사는 '23년 수익성 관리를 위해 제품과 서비스의 가치를 일관되게 강조하면서 원가 개선 노력을 우선시할 것입니다. 반면, 단기적 재고 조정에도 불구하고 고객의 성장 지원에 대한 당사의 약속은 여전히 견고합니다. 당사는 장기적인 Capa를 계획하기 위해 고객과 긴밀히 협력할 것입니다.

향후 당사의 중장기 Capa는 HPC와 5G라는 업계 메가트렌드에 의해 채워질 것으로 예상됩니다. 현재 AI 관련 수요가 증가함에 따라 성능 및 에너지 효율적인 컴퓨팅에 대한 요구가 높아지고 있으며, 이는 선단공정에 대한 요구로 이어지고 있습니다.

당사의 GAA 기술을 통해 고객에게 최적의 성능, 전력 효율성

및 비용 효율성을 제공할 수 있습니다. 이것은 에너지 효율적인 컴퓨팅에 대한 증가하는 수요를 완벽하게 충족합니다. 최근 고객들은 HPC 및 5G 애플리케이션 모두에서 GAA에 대한 상당한 관심을 표했습니다.

당사는 작년에 3나노 GAA 제품의 양산을 시작했으며. 현재 3나노 GAA 공정을 사용한 세 번째 제품도 양산 중입니다. 동시에 당사는 계획에 따라 2세대 3나노 GAA 기술을 개발하고 있습니다. 또한 2나노 GAA 기술의 개발이 순조롭게 진행되고 있으며 2025년 대량 생산이 예정되어 있습니다.

또한 당사는 미국과 한국에서 SFF 및 SAFE 2023를 성공적으로 개최했습니다. 이러한 행사는 공정 로드맵과 다양한 기술 혁신을 제시하는 플랫폼 역할을 했습니다. 특히 당사는 고급 패키징 기술을 홍보하고 올인원 솔루션을 제공하는 것을 목표로 에코시스템 파트너와 협력하여 Multi-Die Integration Alliance를 시작했습니다.

하반기에는 주로 지정학적 위험, 예상보다 느린 수요 회복, 지속적인 고객 재고 조정으로 인해 시장 회복 강도를 둘러싼 상당한 불확실성이 남아 있습니다. 그러나 소비 심리가 반등하고 인플레이션이 완화되며 고객사들이 더 건전하고 지속 가능한 수준에서 재고 조정을 완료함에 따라 수요가 점진적으로 개선될 것으로 예상합니다.

당사는 향후 견고한 성장 기반을 구축하기 위해 최적의 성능과 에너지 효율을 갖춘 GAA 기술 개발에 주력하겠습니다. 동시에 8nm eMRAM과 같은 성숙 공정과 차량용 응용처로 맞춤화된 8인치 기술을 지속적으로 개발하여 제품 포트폴리오를 확장하기 위해 노력하고 있습니다.

이것으로 파운드리 비즈니스의 핵심 메시지를 마칩니다.

감사합니다.

안녕하십니까?

삼성디스플레이 기획팀 최권영 부사장입니다.

2분기 당시 경영 실적에 대해 말씀 드리겠습니다.

2분기는 고물가, 경기침체의 영향으로 다른 산업뿐만 아니라 디스플레이도 어려운 환경이 지속되었습니다.

중소형 사업은, 전체 스마트폰 시장 수요는 감소되었으나, 당사의 전략 거래선들이 어려운 와중에도 프리미엄 제품 분야에서 안정적 실적을 거두었고 당사도 성능과 기술이 차별화된 OLED를 제공하여 안정적인 시장 점유율을 유지하며 전문기 수준의 실적을 달성하였습니다.

대형사업은, 지속적인 수율 개선과 생산성 향상으로 사업 체질을 개선하고 있습니다. 초대형 77" 중심으로 제품 믹스를 고도화하는 등 QD제품의 프리미엄 입지를 계속 강화 중입니다.

다음은 하반기 전망과 당사 전략에 대해 말씀드리도록 하겠습니다.

하반기 스마트폰 시장은 다수의 업체들의 신제품 출시가 예정되어 있어서 상반기 대비 실적 개선이 전망됩니다. 당사는 특히, 폴더블 뿐만 아니라 HIAA, HOP와 같은

하반기 주요 신기술에서도 경쟁사 대비 축적된 기술력을 보유하고 있으며 이미 높은 수준의 기술적 완성도를 확보하였습니다.

이를 기반으로 경쟁사와의 격차를 유지하고 고객 신제품 양산 일정에 차질없이 대응할 계획입니다.

대형 시장은, 경기 부진 및 엔터믹 영향으로 수요 불확실성이 존재 합니다. 상대적으로 양호한 초대형 사이즈 증량 등을 고객사와 협의하여 추진하도록 하겠습니다.

당사는, 5월 마이크로 디스플레이 업체 eMAGIN을 인수하였습니다. 향후 고성장이 전망되는 XR용 디스플레이 시장에서도 적극적인 기술 개발을 하여 시장을 리딩할 수 있도록 하겠습니다.

감사합니다.

안녕하십니까? MX사업부 다니엘 아라우조입니다.

MX사업부의 '23년 2분기 실적과 하반기 전망에 대해 말씀 드리겠습니다.

'23년 2분기 시장은 지속되는 금리 인상과 인플레이션 등 매크로 영향으로 전분기비 스마트폰 시장 수요가 감소하였습니다.

MX 사업은 플래그십 신제품 출시 효과 감소로 인한 프리미엄 비중 감소와, 경기 침체와 중저가 시장 회복 지연의 영향으로 전분기 대비 매출이 감소하였습니다.

그러나, S23 시리즈는 상반기 기준 수량과 금액 모두 전작비 견조한 판매를 이어나가고 있고, A시리즈 또한, Up-selling 및 신제품 중심 판매에 따른 2분기 모델 믹스 개선의 성과가 있었습니다.

더불어, 주요 원자재 가격 안정화에 기반한 개발/제조/물류 등 프로세스 전반에 걸친 최적화 및 효율화로 두 자릿수 수익성을 유지하였습니다.

다음으로 '23년 하반기 전망을 말씀드리겠습니다.

하반기 스마트폰 시장은 프리미엄 중심으로 수요가 확대되어 전년 대비 성장세로 전환될 전망입니다.

다만, 시장조사기관에서 전망하는 시장 증가 규모는 축소되고 있으며 글로벌 경기침체 지속 Risk가 반영되면 추가 축소될 가능성도 있습니다.

태블릿 시장은 전년 동등 수준으로 유지되겠지만 프리미엄/대화면 등 고가 제품에 대한 수요는 증가할 것으로 예상됩니다.

스마트워치 시장은 작년 수요 급증에 따른 기저효과로 역성장이 전망되며, TWS 시장은 신흥시장 중심 저가 Segment 확대로 소폭 성장 전망됩니다.

MX 사업은, 플래그십 중심 판매 확대와 업셀링을 통한 매출 성장 기조 아래, 제품 완성도를 제고하고 폼팩터에 특화된 차별화 경험을 더욱 강화한 Flip5/Fold5를 성공적으로 출시하고, 안정적인 재고 운영下 거래선과의 긴밀한 협업을 통해 출시 초부터 확실한 판매 호조를 이끌어내어 글로벌 폴더블 스마트폰 시장 리더십을 더욱 공고화 하겠습니다.

S23 시리즈는 마케팅 활동을 강화하면서 지역별 계절성도 적극적으로 활용하여 하반기에도 판매 확대를 이어가겠습니다.

A시리즈는 파트너 협업 및 지역별/고객별 맞춤 판매 프로그램을 적극 실행하여 High/Mid 업셀링 및 고객

Retention을 제고하겠습니다.

태블릿과 웨어러블도 프리미엄 신제품 중심 매출 극대화  
기조下 제품 경쟁력 및 프리미엄 Eco 경험을 강화하고,  
공동 언팩 등을 통해 판매를 확대하여 프리미엄 세그内 입지  
확대를 추진하겠습니다.

이를 통해, '23년 연간 매출 성장을 추진하고 시장 변화에  
대응하는 운영 효율화를 통해 연간 두 자릿수 수익성을 확보할  
수 있도록 노력하겠습니다.

감사합니다.

안녕하십니까.

삼성전자 VD 사업부 영상전략마케팅팀 노경래 상무입니다.

먼저 '23년 2분기 시황 및 실적에 대해 말씀드리겠습니다.

'23년 2분기 TV 시장 수요는 계절성 영향으로 전분기 대비 감소하였으며, 전년 동기의 러-우 지정학적 이슈 등 기저 효과 영향으로 전년비 수요 감소는 완화되는 추세입니다.

당사는 신모델 출시 기반 Neo QLED/OLED/초대형 등 고부가 제품군 판매에 주력하여 프리미엄 시장 리더십을 확대함과 동시에, 재료비/물류비와 같은 제반 비용을 절감하여 전년비 수익성을 개선하였습니다.

이어서 '23년 하반기 전망에 대하여 말씀드리겠습니다.

하반기 TV 시장은 각종 사업환경 불확실성과 risk가 상존하는 가운데 전체 TV 수요 감소폭이 성수기 중심으로 완화될 것으로 전망되며, 프리미엄/초대형 제품군 시장은 여전히 견조할 것으로 예상됩니다.

당사는 Neo QLED/OLED 및 Lifestyle Screen과 같은 전략제품 중심 판매 프로그램 강화로 성수기 수요를 선점하고, 98" 초대형/Micro LED/세계 최초 대형 OLED 게이밍 모니터 등 혁신제품을 활용하여 프리미엄 시장을 지속 선도해

나가겠습니다.

또한 환경/보안/컨텐츠 등 주요 소비자 가치와 연계한 기능들을 당사 제품의 특장점으로 적극 소구하여 업계 리더로서의 위상을 더욱 공고히 하겠습니다.

감사합니다.

감사합니다. 이상으로 2분기 실적 관련 Presentation을 마칩니다. Q&A 들어가기에 앞서, 여러분의 편의를 위해 주요 제품별 Data Points를 먼저 말씀 드리겠습니다.

다만, 여러가지 매크로 불확실성이 여전히 높은 상황인 바, 연간 가이던스는 제공하지 않습니다. 비교 수치는 전분기 대비입니다.

D램의 경우 2분기 당사의 Bit Growth는 10% 중반 성장을 기록했습니다. ASP는 한 자릿수 중후반 하락을 2분기에 기록했습니다. 3분기의 경우 D램의 수요 Bit Growth는 10% 중반을 기록할 것으로 예상하고 있습니다. 당사도 시장 수준의 3분기 D램 Bit Growth 성장을 예상하고 있습니다.

NAND 2분기 당사 Bit Growth는 한 자릿수 중반 성장했고, ASP는 한 자릿수 중후반으로 낸드의 경우 2분기 하락했습니다. 3분기 낸드의 수요 Bit Growth는 한 자릿수 중후반 성장이 예상되고 있고 당사의 낸드 Bit Growth는 시장은 소폭 상회할 것으로 전망하고 있습니다.

디스플레이의 경우 2분기 중소형이 매출에서 차지하는 비중은 90% 후반대였고, 중소형 패널 판매량은 한자릿수 초반 성장했습니다.

MX의 경우, 2분기 스마트폰 판매량은 5,300만대, 태블릿 600만대를 기록했고, 스마트폰 ASP는 269달러를 기록했습니다. 3분기 스마트폰과 태블릿 판매량은 전 분기 대비 증가가 예상됩니다. 스마트폰 ASP도 전 분기 대비 상승을 예상합니다.

2분기 TV 판매량은 10% 초반 하락했습니다. 3분기 TV 판매량은 한자릿수 후반 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

이제 Q&A 세션으로 넘어가도록 하겠습니다.

- Q&A 세션

### 【 KB증권 김동원 상무】

첫 번째 질문 기회 주셔서 감사합니다. 저는 메모리와 디스플레이 질문 드리겠습니다.

- 먼저 하반기 메모리 반도체 수요와 공급 전망에 대해 의견 공유해 주시면 감사하겠습니다.
- 다음은 OLED 기술 경쟁력 강화와 IP프로텍션 관련해, 현재 진행 중인 ITC 제소권의 현황과 확대 가능성에 대해 말씀 부탁드립니다.

### 【 답변 】

- 메모리부터 답변 드리겠습니다.

상반기에는 매크로 불확실성 증가와 함께 고객사들의 재무 건전화를 위한 재고 조정으로 가격이 하락세를 보였습니다. 다만 한 가지 말씀 드리고 싶은 점은 고객사 재고조정이 상당수준 진행되었고 2분기에는 1분기 대비 가격 하락폭이 확연히 둔화되었다는 겁니다.

상반기에는 전반적인 세트 수요 부진이 이어져 왔으나 하반기에는 세트 재고조정이 상대적으로 진전된 PC 모바일 위주로 상반기 대비로는 수요가 개선될 것으로 전망되고 공급

측면에서도 업계의 감산 폭 확대 영향으로 인해 하반기 중에는 일부 시장 변화가 있을 것으로 예상하고 있습니다.

D램의 경우 특히 TSV와 HKMG와 같은 특수 공정이 적용된 제품들은 CAPA 제약 상황에 반해 수요 증가가 예상되고 있어서 타 제품에 선행하여 가격 반등이 있을 것으로 전망되고 반면 낸드는 시장 변화 시점이 D램보다는 후행 할 것으로 판단됩니다.

- 디스플레이 답변 드리겠습니다.

현재 진행 중인 OLED IP 관련 소송에 대해 질문 주셨고, 최근의 언론 통해 알려진 것처럼 ITC 제소 이후에 경쟁사와의 특허침해소송이 미국과 중국으로 현재 진행 중입니다. 당사는 처음 OLED 시장을 개척하고, 현재 큰 사업으로 발전할 때까지 세상에 없던 기술에 도전하며 수많은 혁신 기술을 상용화 해왔습니다. 이 과정에서 많은 시간, 인력, 자금이 투입된 만큼, 이런 기술들은 특히 등록을 통해 회사 자산으로 엄격히 보호하고 있습니다.

최근 경쟁이 본격화되면서 당사 경쟁력의 근간이 되는 이런 지적 자산에 대한 도용, 침해 행위가 늘어나고 있습니다. 당사는 더 이상 간과할 수 없는 수준이라고 판단하고, 법적 제재 등 다양한 방안을 강구하게 되었습니다. 특히 침해는 단순히 개별 기업의 경쟁력 저해에 그치지 않고, 결국 경쟁의

률과 산업 생태계를 무너뜨린다고 생각합니다. 당사는 앞으로도 OLED 산업의 선두주자로서 기술 개발은 물론 기술 자산 보호를 위해 건강하고 공정한 산업 생태계 조성을 위해 최선의 노력 다하겠습니다.

질문 주신 ITC 건은 현재 진행 중인 소송이어서 구체적인 답변을 드리긴 어렵습니다.

### 【 Daiwa, 김성규】

질문 기회 주셔서 감사합니다. 메모리 쪽과 MX 관련해 하나씩 질문 드리겠습니다.

- 우선 메모리 사업부는 지난 분기 초에 메모리 생산량 하향 조정, 의미 있는 감산을 발표하셨는데, 2분기 현황이 어떤지 그리고 하반기 생산은 어떻게 운영할 예정인지 궁금합니다. 그리고 이 감산에 따른 하반기의 재고 수준 전망은 어떠할지 의견 부탁 드립니다.
- MX 관련해서는 어제 갤럭시 언팩 행사에서 폴더블 신제품을 발표하셨는데, 올해 폴더블 스마트폰 시장 전망, 시장 규모라든지 성장 전망과 이번에 출시한 신제품 판매 확대를 위해서 어떤 전략을 가지고 계시는지 공유 부탁 드리겠습니다.

## 【 답변 】

- 메모리부터 답변 드리겠습니다.

수요 부진으로 인해서 상반기 당사 재고는 높은 수준으로 마감됐지만 긍정적인 점은 생산량 하향 조정으로 DRAM/NAND 재고 모두 5월 피크를 기록한 이후 빠른 속도로 감소하고 있다는 것입니다. 당사는 하반기에도 생산 하향 조정을 지속할 예정이며, 이에 더해 재고 정상화를 가속화하기 위해 DRAM, NAND 공히 제품별 선별적인 추가 생산 조정을 진행 중으로 특히 NAND 위주 생산 하향 조정 폭을 크게 적용할 예정입니다.

또, 하반기에는 수익성 중심의 시장 대응을 강화해 나가려고 합니다. 구체적으로 HBM, DDR5, LPDDR5X, UFS4.0, PCIe Gen 5 SSD 등 고부가가치 제품의 생산과 판매 비중 확대를 통해 당사 포트폴리오의 질적 개선을 기대하는 한편, 1a나노, V7 등 선단 공정의 판매량 확대가 레거시 공정의 생산 하향 조정과 맞물려서 선단 공정의 비중 증가 효과는 더욱 뚜렷하게 나타날 것으로 예상됩니다. 감사합니다.

- 두 번째 질문에 대한 답을 드리도록 하겠습니다.

당사는 폴더블 카테고리를 선도적으로 개척해왔고, 당사 폴더블 경쟁력은 시장에서 높은 평가 받고 있습니다. 또한 폴더블은 플래그십 성장의 새로운 동력으로 키워갈 계획입니다. 2023년 폴더블 시장은 작년에 이어 성장세가 전망되고 있고, 플래그십 시장 내의 비중도 지속 확대될

것으로 보고 있습니다.

어제 언팩에서 공개했듯이, 플립5는 더 커진 커버 스크린과, 슬림한 두께로 디자인 완성도를 높였고, 폼팩터에 특화된 경험도 더 강화했습니다.

예를 들어 사용자들은 후면 카메라를 활용하여 다양한 각도로 고화질 셀피를 촬영할 수 있으며, 플렉스 윈도우를 통해 자신의 개성을 표현하고, 다양한 테스크를 편리하고 빠르게 처리할 수 있습니다. 홀드 5의 경우에는 플렉스 힌지를 적용해서 전작보다 더 얇고 가벼워졌고, 또한 고성능 AP를 탑재해서 발열 제어 및 소프트웨어 최적화로 개인 경험을 더욱 향상시켰습니다.

또한 폴더 고객이 많이 사용하는 멀티 태스킹 기능을 개선했고, 더 슬림해진 S펜 탑재 등으로 생산성도 극대화했습니다.

제품의 완성도를 높이면서 마케팅과 영업 전략도 고도화해서 글로벌 폴더블 시장 리더십을 더욱 공고화하겠습니다.

금번 언팩은 처음으로 전통과 미래가 공존하고 또 글로벌 트렌드 변화와 혁신의 도시인 서울에서 개최되었습니다. 이를 통해서 글로벌 미디어나 테크 인플루언서들에게 더욱 깊이 있는 제품 정보와 체험을 제공해서 버즈 창출을 지속하고자 했습니다. 또한 당사의 강점인 거래선과의 마케팅 협업을 강화해 출시 초부터 확실한 판매 호조를 이끌어내도록

하겠습니다.

마지막으로 갤럭시 폴더블만의 차별화된 경험을 플렉스라고 브랜딩화해서 폴더블 선망성을 제고하겠습니다.

### 【 Citi, 이세철 】

저는 요즘 시장에서 많이 관심을 갖고 있는 반도체 쪽 AI 방향성 관련해서 두 가지 질문 드리겠습니다.

- 첫 번째 질문은 메모리 관련 AI 시장 확대로 인해서 HBM 시장에도 긍정적인 영향이 계속 있을 것으로 보여지는데, HBM 시장 전망과 그리고 삼성전자의 대응 현황에 대해서 설명 부탁 드리겠습니다.
- 두 번째 질문도 같은 AI 방향성 관련해서 파운드리와 패키징 관련 질문인데요. 최근 Generative AI 봄으로 인해서 기존 컴퓨팅 구조인 폰노이만 구조에서 AI 컴퓨팅을 위한 구조로 변화하고 있는데 메모리의 HBM 뿐만 아니라 로직 그리고 첨단 패키지까지 수혜가 예상됩니다. 앞서 발표에서도 멀티 다이 인테그레이션 얼라이언스에 대해서도 언급을 하셨는데요. 이에 따른 파운드리 패키지 쪽에서의 AI 향 삼성전자 전략에 대해서 설명 부탁 드리겠습니다

## 【답변】

- 메모리에서 먼저 답변 드리겠습니다.  
말씀하신 것처럼 최근 Generative AI 시장이 성장함에 따라서 대규모 데이터 처리를 지원하는 고성능 메모리 특히 HBM 수요가 빠르게 늘어날 것으로 예상하고 있습니다.

HBM 수요는 중장기 관점에서는 외부 기관의 전망 기준 앞으로 5년 동안 CAGR 30% 중후반의 성장이 예상되고 있습니다. 반면에 단기적으로는 Hyperscaler 업체들의 Generative AI 서비스 경쟁 심화로 인해서 많은 고객들의 수요가 접수되고 있고, 특히 올해와 내년 가파른 수요 성장이 기대됩니다. 이러한 수요 성장세에 맞춰 당사는 HBM 사업을 확대해 나가고 있습니다.

먼저 제품 관점에서 말씀 드리자면, 당사는 HBM 시장의 선두업체로서 HBM2를 주요 고객사에 독점 공급했었고, 후속으로 HBM2E도 제품 사업을 원활히 진행하고 있습니다.

그 다음 세대인 HBM3에서도 업계 최고 수준의 성능과 용량으로 고객 퀄을 진행 중으로, 이미 8단 16GB와 12단 24GB 제품을 주요 AI SoC 업체와 클라우드 업체에 출하 시작하였습니다. 다음 세대인 HBM3P 제품은 24GB 기반으로 하반기 출시 예정이고, 이 역시 업계 최고 수준의 성능과 용량으로 준비해, 더욱 높아지고 있는 AI 시장의 요구에 적극 대응할

계획입니다.

다음으로 HBM 공급 역량 측면에서도 말씀을 드리겠습니다.

당사는 HBM 시장 내 메이저 공급업체로서, 지속적인 투자를 바탕으로 업계 최고 수준의 HBM 생산 능력을 유지하고 있습니다. 이를 기반으로 올해는 전년 대비 2배 수준인 10억GB 중반을 넘어서는 고객 수요를 이미 확보하였고, 하반기 추가 수주에 대비하여 생산성 향상을 통한 공급 역량 확대를 추진 중에 있습니다.

뿐만 아니라, 미래 급증하는 수요에 맞춰 공급 능력을 지속 확대해 나갈 계획으로, 현재 '24년 HBM CAPA는 증설 투자를 통해 '23년 대비 최소 2배 이상 확보 중이고, 향후 수요 변화에 따라 추가 대응할 계획입니다.

당사는 앞으로도 HBM의 선두업체로서 최고 수준의 기술을 유지함과 동시에, 향후 HBM 수요 본격 확대에 맞춘 적기 공급 대응을 통해 업계 리더십을 지속 제고해 나가도록 하겠습니다. 감사합니다.

- 파운드리 답변 드리겠습니다.

Generative AI 붐으로 인해 HBM 메모리뿐 아니라 CPU, GPU, AI 가속기 등 AI칩도 그 수요가 최소 향후 5년간 고속으로 성장할 것으로 전망됩니다. 이러한 AI칩, 패럴렐 프로세싱 구조의

칩은 고성능과 높은 에너지 효율이 매우 중요합니다. 당사가 작년에 세계 최초로 양산에 성공했던 GAA의 공정은 고성능과 높은 에너지 효율을 요구하는 AI칩의 최적화된 선단 공정입니다. 당사는 2025년 2나노 GAA의 공정 양산을 통해서 기술 리더십으로 AI칩 시장을 선도하겠습니다.

또 AI칩은 HBM 메모리와 하나의 칩으로 패키징 되고 있습니다. 이를 가능케 하는 Advanced Packaging 기술과 Capa가 점점 중요해지고 있습니다. 고객들은 파운드리, 메모리, 패키징 등 일련의 과정을 하나의 업체에게 맡기고 싶어합니다. 당사의 강점은 GAA 공정, 메모리, HBM 메모리, Advanced Packaging 기술을 모두 보유하고 있다는 점입니다.

이러한 강점을 극대화하기 위해서 EDA, IP, 기판, 테스트 분야의 에코 시스템 파트너들과 함께 MDI를 지난달에 출범시켰습니다. 이를 통해 고객들이 원하는 원스탑 올 일원 서비스를 적시에 제공한다는 전략에 따라서 사업을 전개하고 있습니다. 감사합니다.

【 JP Morgan, 박정준 】  
질문 기회 감사 드립니다.

- 첫 번째는 HBM 백엔드 기술 관련해서 삼성 현재 TC본딩 쪽에서 NCF 기술을 적용하고 있는데 이것에 대해 자세한 설명

부탁 드립니다. 경쟁사는 MR-MUF라고 있는데, NCF 와의 차이점과 장점 설명 부탁 드립니다.

- 두 번째는 프리젠테이션에서 말씀하실 때 eMAGIN社 인수하셨다 했는데, 인수 배경과 향후 마이크로 디스플레이 쪽에 어떤 전략을 갖고 계신지 말씀해 주시면 감사 드리겠습니다.

## 【 답변 】

- 첫 번째 질문에 대한 답변 드리겠습니다.

HBM 조립 기술 관련된 부분 먼저 말씀 드리겠습니다. HBM은 수직적으로 D램 칩을 적층하고 TSV를 통해 연결하는 구조로 상하부 칩의 TSV를 연결하기 위해 마이크로 범프를 사용하게 되는데, 이 때 중요한 게 마이크로 범프 간의 Gap을 채우는 기술입니다.

당사가 독자적으로 개발한 NCF 기술은 필름을 사용해 캡을 채우기 때문에 근본적으로 Gap 내 보이드가 없고, 열과 압력을 사용하여 칩을 연결하는 서멀 컴프레션 공정 또한 이미 다년간 양산을 통해 수율과 품질에 문제가 없음이 검증된 기술입니다. 덧붙여 당사는 특성이 훨씬 더 개선된 최첨단 NCF 소재를 새롭게 개발해 현재 양산 중인 HBM3 제품에 적용하고 있으며, 향상된 품질과 양산성을 확보하여 고객에 출하 중입니다.

성능 측면에서도 고속으로 동작하는 HBM의 특성 상, 동작 시 발생하는 열을 밖으로 잘 방출하도록 칩들의 간극을 줄이는 기술이 중요한데, 보이드가 없는 NCF는 이러한 간극을 줄이는 데 효과적입니다.

이를 기반으로 당사는 HBM3 12단 스펙 제품의 칩 간극을 줄이고, 씨멀 특성을 향상시키는 데 유리한 세계 최초 7마이크로 기술을 적용해 양산 중입니다. 생산성 측면에서도 NCF 공정은 접합 물질인 솔더 표면에 산화막 제거 기능이 포함돼 있어서, 본딩 시 발생되는 솔더 산화막 제거를 위해 사용되는 세정, 가열 등의 부가 공정이 필요 없습니다.

또한 칩을 고속으로 정밀하게 적층하는 공정과 솔더를 접합하는 공정을 구분해 최적의 공정과 설비를 개발해 8단 제품에서도 충분한 경쟁력을 갖춘 생산성을 확보했습니다.

'24년부터 채용이 증가할 것으로 전망되는 12단 HBM 제품의 경우 스택 수 증가에 따른 칩 두께의 감소로 인해서 칩 휘어짐에 기인한 기술적 문제들이 발생할 수 있습니다. 하지만 당사의 NCF 기술은 칩 전면을 열과 하중을 가해 본딩하는 방식이기 때문에 칩의 휘어짐을 상대적으로 용이하게 제어할 수 있어 12단 제품에서의 당사 NCF 기술의 경쟁력은 더욱 강화될 것으로 전망됩니다.

또한 미래 HBM 제품의 두께 제약폭이 필요한 HBM4의 16단 초고용량 제품에서도 당사는 칩 간 Gap을 완전히 없애고 칩과 칩을 직접 접합하는 신공정을 개발 중으로 미래 시장의 수요에 대응하기 위한 기반 기술을 선행하여 준비해 나가고 있습니다. 당사는 이와 같이 지속적인 신기술 확보를 통해 HBM 선도업체로서의 리더십을 강화해 나갈 예정입니다.

감사합니다.

- 디스플레이 부문 답변 드리겠습니다.

질문 주신 것처럼 당사는 지난 5월 2900억원 정도를 투자해 미국 마이크로 디스플레이 업체인 eMAGIN과 인수계약을 체결했습니다. 현재는 기업결합 및 각국 승인을 위한 후속 절차를 진행중이고 연말 정도에 최종 작업이 마무리될 것으로 기대하고 있습니다.

인수의 가장 큰 목적은 미래 성장동력인 XR 기기 시장에 대한 기술 대응력을 높이기 위함입니다. 최근 XR 기기 생태계가 빠르게 활성화되고 있고, 업계에선 XR 기기가 대중화되면 스마트폰을 능가하는, 사람들의 일상에 근본적인 변화를 가져올 것으로 예상하고 있습니다.

eMAGIN社는 2001년부터 XR 기기 핵심 부품인 마이크로 디스플레이를 개발해온 업체로서 특히 초고해상도,

올레도스(OLEDoS) 제조에 필요한 원천특허 및 공정 기술을 보유하고 있습니다. 당사도 역시 작년부터 전담 개발팀 구성했고, 올레도스, 레도스(LEDoS) 등 차세대 마이크로 디스플레이 개발에 집중하고 있는 만큼, 이매진 인수를 통해 XR 사업 경쟁력을 높이고, 더 다양한 고객들에게 혁신적 마이크로디스플레이 솔루션을 제공할 것으로 기대하고 있습니다.

당사는 앞으로도 차별화 기술 확보 및 미래 기술 선점을 위해 다양한 방면으로 기술 센싱을 지속할 것이고 투자 및 협력 확대할 계획입니다.

### 【 한국투자증권, 채민숙 】

질문 기회 주셔서 감사합니다.

- 저는 메모리 관련해서 Automotive 시장에 대해 질문 드리려고 하는데요, Automotive 시장이 메모리에 대해서 지금까지는 수량도 작고 품질은 좀 까다로워서 다소 중요성이 떨어진 경향이 있었는데, 자율 주행 등과 더불어 최근에는 과거와 달리 중요도가 높아지고 있는 것 같습니다.  
향후 Automotive 향 메모리 시장 전망을 어떻게 보시는지와 이에 대한 삼성전자의 준비 상황에 대해 업데이트 해 주시면 감사하겠습니다.

## 【 답변 】

- Automotive 메모리 시장 관련 답변 드리겠습니다.

전기차와 자율주행차 시대가 도래함에 따라서 차량용 메모리 수요도 강세를 보이고 있습니다. Auto 메모리 시장은 금액 기준으로 향후 5년간 매년 평균 30% 중후반의 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 실제 Automotive 향 메모리 수요는 빠르게 증가해 2030년 초에는 PC 응용보다도 더 큰 사업 기회가 될 것으로 보여 당사는 관련된 사업 경쟁력을 지속 강화해 나가고 있습니다.

특히 차량은 사람의 생명과도 직결되는 만큼 오토모티브 제품의 신뢰도와 안정성 확보에 집중하고 있습니다. 그 결과 당사 오토모티브 UFS 3.1 제품에 대해 지난 23년 4월 독일의 메이저 Tier1 고객사로부터 ASPICE CL2 프로세스 및 제품 인증을 국내 업체 최초로 받았고, 6월 말에는 전 세계적으로 공신력을 가진 자동차 인증 기관인 씨엔비스사를 통해 실제 고객사에 공급하고 있는 제품으로 다시 한 번 인증을 획득했습니다..

이는 당사 오토모티브 UFS 3.1 제품이 고객사와 인증 기관 둘 다에서 풀 피처에 대한 인증을 확보한 것입니다. ASPICE는 차량용 소프트웨어 개발 프로세스의 신뢰도와 역량을 평가하는 개발 표준으로, 당사 전장향 메모리 제품은 금번 CL2 인증을 통해서 차량용 반도체 시장에서 요구하는 높은 수준의

안정성과 품질 수준을 국제적으로 검증 및 공인 받았다고 할 수 있습니다.

이와 더불어 당사는 Automotive 메모리의 소비 전력 개선 측면에서도 지속적인 기술 개발을 진행하고 있습니다. 이달 초 양산을 시작한 인포테인먼트향 USF 3.1은 업계 최저 수준의 소비 전력을 갖고 있어 자동차의 배터리 전력 운영 효율을 높일 수 있기에 전기차, 자율주행차 등의 최적의 메모리 솔루션이 될 것으로 기대하고 있습니다.

이처럼 당사는 제품 안정성과 소비 전력 등 Automotive 시장의 차별화된 제품을 기반으로 업계 최고 수준의 풀 라인업을 구축하였습니다. 또한 Automotive 사업을 시작한 지난 8년 동안 단 한 번의 공급 이슈 없이 주요 고객들과의 신뢰를 쌓아왔고, 현재는 메이저 카 OEM 및 Tier1 업체에 모두 진입을 완료한 상태입니다. 앞으로도 당사는 경쟁력 있는 제품을 기반으로 고객사와 지속 협업하며, Automotive 시장에서의 리더십을 강화해 나가겠습니다.

### 【 UBS, Nicolas Gaudois 】

질문 기회에 감사 드립니다. 저는 메모리와 디스플레이 질문 드리겠습니다.

- 앞서서 이야기가 있었지만, 클라우드와 그리고 AI의

성장으로 인해서 사실은 HBM 외에도 여러 가지 측면에서 메모리 관련된 기술 요건이 좀 더 까다로워지고, 새로운 요건들이 나타날 것으로 생각이 됩니다.

AI와 관련된 메모리 기회가 상당히 큰 기회이기 때문에, 이것을 수익화하기 위해서 귀사에서는 어떤 기술 분야에 중점을 두고 중장기적으로 준비하고 계시는지 궁금합니다

### 【 답변 】

- 말씀하신대로 최근 클라우드 및 AI 성장에 힘입어 서버와 그래픽 응용을 포함한 다양한 응용에서 메모리 시장 요구가 빠르게 변화하고 있습니다. 당사는 메모리 업계의 리더로서 이러한 시장 요구에 맞춰 여러 분야에서 미래 기술을 확보해 나가고 있습니다.

먼저 데이터 센터향 AI에 필요한 고용량 모듈 수요 대응을 위해 32GB DDR5 제품을 출시할 예정입니다. AI 고성능 컴퓨팅에 쓰이는 하이코어 CPU는 기존 CPU 대비 더 큰 메모리 용량과 대역폭을 필요로 합니다. 이 과정에서 최적의 스피드를 내기 위해서는 한 채널의 여러 D램 모듈을 사용하는 것보다 한 개의 고용량 모듈을 사용하는 것이 가장 효과적이고 따라서 최근 용량이 큰 모듈에 대한 시장 니즈가 커지고 있습니다. 이에 당사는 선단 공정 기반의 32GB DDR5 제품을 연내 출시할 예정으로 이를 기반으로 한 고용량 모듈을 통해 급증하는 고성능 컴퓨팅 수요에 적극 대응할 계획입니다.

다음으로 당사는 GDDR에서도 업계 최고 수준의 제품을 지속 확보해 나가고 있습니다. 당사는 얼마 전 업계 최초로 최고 성능의 32Gbps GDDR7을 개발을 했습니다. GDDR7은 전 세대인 GDDR6 대비 데이터 속도가 1.4배 빠르고 전력 효율은 20% 향상된 제품입니다. 이러한 성능을 기반으로 저희는 GDDR7이 PC와 게이밍 응용뿐만 아니라 고성능 컴퓨팅과 AI 등에 폭넓게 사용될 것으로 기대하고 있습니다.

한편 On-Device AI 등에 특화된 LLW(Low Latency Wide) IO D램도 개발하고 있습니다. Generative AI는 현재 주로 서버 기반으로 발전하고 있지만 효율성과 보안 등의 이유로 AI를 기기 자체에서 구현하는 On-Device AI 기술 또한 확대 중입니다. LLW는 저지연, 저전력 특성과 함께 기존 LPDDR 대비 월등히 높은 고대역 폭을 가지고 있어 기계에서 생성되는 데이터를 실시간으로 처리할 수 있습니다. 이에 당사는 On-Device AI 시장 성장과 연계해 업계 주요 파트너들과 지속 협업하며, 제품 개발 중으로 24년 말 양산을 목표로 하고 있습니다.

또한 데이터센터향 AI에 특화된 Advanced Package 기술로 로직과 바로 결합할 수 있는 DRAM 제품을 개발 준비 중입니다. 이는 SRAM보다 경제적일 뿐만 아니라 더 큰 용량을 구현할 수 있어 AI 모델 거대화와 함께 급증하는 데이터를 효과적으로 처리할 수 있습니다. 당사는 주요 CPU 고객과의 협의를

바탕으로 제품 상세 스펙에 대한 정의를 이미 완료한 상태이며, 이를 기반으로 차별화된 솔루션 제공을 준비하고 있습니다.

뿐만 아니라 LPDDR 기반 모듈인 LPCAMM도 개발했습니다. 그동안 저전력의 LPDDR 제품은 주로 모바일 기기에 단품으로 쓰였는데, 최근 주요 클라이언트, PC 및 서버 고객사 중심으로 기존 DDR 모듈이 아닌 LPDDR 모듈을 채용해 전력 소모를 줄이고자 하는 니즈가 생겨나고 있습니다. 이에 당사는 업계 최초로 LPCAMM이라는 LPDDR 모듈을 개발했고 내년 상반기 중 시제품 양산을 시작해 하반기 클라이언트, PC 및 서버 향 저전력 수요에 대응할 계획입니다.

이와 더불어 당사는 초거대 AI 모델 처리에 적합한 HBM-PIM과 CXL 기반 PNM 등 메모리 반도체 솔루션에 대한 개발 활동도 지속하고 있습니다. 이들 기술은 메모리 내 혹은 가까이에 프로세스를 배치함으로써 CPU 와 메모리 간 데이터 병목 현상을 개선시킬 수 있습니다. 실제로 HBM PIM을 적용하여 성능 개선 효과를 계산해 본 결과, 기존의 GPU 가속기 활용 대비 AI 모델의 성능이 약 3.4배 이상 향상됨을 확인하였으며 CXL 기반의 PNM 솔루션의 경우, 메모리 용량 추가를 통해 기존 GPU 가속기 대비 4배의 용량으로 활용이 가능합니다.

마지막으로 스토리지 관점에서 말씀 드리자면, 데이터가 점차

방대해짐에 따라 고용량 스토리지에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 당사는 미래 기술 개발 측면에서 고용량 수요에 대응할 수 있도록 내년 초 업계 최초 TLC 기반 최고 용량, 최고 성능 64TB 서버 SSD를 출시할 예정입니다. 지금까지 미래 기술 관련 준비 상황을 공유 드렸습니다.

당사는 메모리 시장의 선도 업체로서 저희의 기술 경쟁력을 지속 강화할 뿐만 아니라 업계 전체에 새로운 기술 표준을 제시해 메모리 생태계 발전을 이끌고 있습니다. 앞으로도 당사는 미래 시장의 니즈를 적극적으로 살피고 이를 뒷받침하는 기술을 개발하여 시장 리더십을 공고히 해나가겠습니다.

마지막으로 질문해 주실 분은 CIMB 증권의 이수빈님입니다.

### 【 CIMB, 이수빈 】

- 질문 기회 주셔서 감사합니다. W-OLED 도입 기사 계속 이어지고 있는데, 삼성전자 OLED TV 같은 프리미엄 제품 라인업 운영 전략과 하반기 전망 말씀 부탁 드립니다..

### 【 답변 】

- VD 답변 드리겠습니다.

글로벌 TV 시장이 다소 정체된 현재 상황에서도 QLED, OLED, 초대형 등 프리미엄 제품에 대한 수요는 지속적으로 견조할

것으로 전망합니다. 이에 당사는 프리미엄 라인업을  
다변화해서 소비자에게 다양한 선택권을 제공할 예정입니다.

이를 위해 하반기에는 당사 프리미엄 라인업의 Backbone인 Neo QLED 제품 경쟁력에 대한 커뮤니케이션을 더욱 강화하고,  
OLED는 작년에 65인치, 55인치 중심으로 주요 지역에 판매해서  
좋은 평가를 받았던 만큼, 올해는 83인치, 77인치 등 초대형  
라인업을 추가 도입하고, 삼성 OLED만의 차별점을 계속해서  
소구하겠습니다.

또한, 98인치는 기존 Neo QLED 제품에 더하여 8K와, QLED  
라인업을 추가 도입하고, 마이크로 LED는 110인치 외에  
89인치를 보강하여 초대형, 초고가 프리미엄 시장을 지속  
창출해 나가겠습니다. 동시에, 당사만의 차별화 제품군인  
라이프스타일 스크린 제품도 적극 활용해 다양한 소비자  
ニ즈를 충족할 계획입니다.

마지막으로 저희가 온라인을 통해 사전에 취합한 질문에 대해  
답변 드리도록 하겠습니다.

지난해부터 개인 투자자들과의 소통 강화 및 이해 제고를 위해  
홈페이지를 통해 사전에 질문하실 수 있도록 했고 이번  
분기에도 많은 분들께서 다양한 질문들을 남겨주셨습니다.

이 중 대부분은 앞서 진행된 질의응답 과정에서 충분히 설명이 된 것으로 보이며 거론되지 않은 질문 중에서 주주들의 관심도가 높은 한 가지 사안에 대해 추가적으로 답변 드리도록 하고 마치겠습니다.

### 【 사전 취합 질문 ① 】

질문은 “최근 MR 디바이스 출시 소식이 전해지면서, 관련 산업이 성장할 것이란 전망이 제기되고 있는데 삼성은 관련 제품 출시나 생태계 구축 계획이 있으신지요?”입니다.

MX 다니얼 아라우조 상무가 답변해 주시겠습니다.

### 【 답변 】

Immerse화한 경험은 이미 가상게임을 넘어서 미디어나 업무 분야까지 확대 적용되고 있고 본격 대중화될 것으로 예상하고 있습니다. 당사는 XR 시장을 성장 기회가 큰 신 사업으로 보고 있고, 핵심 하드웨어나 소프트웨어 기술개발과 함께 콘텐츠 등 생태계 구축을 위해 체계적으로 준비하고 있습니다.

Immerse화한 제품의 기획과 개발을 위한 전담 조직을 이미 셋업하였고, 여러 관계사, 파트너사와 긴밀한 협력을 하고 있습니다. 구글, 퀄컴 등 업계 리딩 파트너들과 중장기 협력을 통해 갤럭시 만의 완성도 높은 혁신 디바이스를 개발하고,

차별화 된 사용자 경험을 제공하기 위해 선제적인 투자를 진행하고 있습니다.

최근 여러 업체가 VR 기반 디바이스로 출시하고 있습니다. 당사도 XR 디바이스에서 갤럭시 에코시스템의 새롭고 차별화한 폼팩터 경험으로 소비자들이 소통하고, 일하고 여가를 즐기는 데에 더 많은 시간을 보낼 수 있도록 제품 완성도 및 XR 생태계를 확보하고 소비자 기대에 부응할 수 있는 시점에 제품을 출시할 수 있도록 준비하고 있습니다.

답변 감사합니다.

투자자 여러분들의 소중한 의견 감사 드리며 주요 경영 의사 결정에 참고하도록 하겠습니다.

그럼 이것으로 이번 분기 컨퍼런스 콜을 마치도록 하겠습니다. 여러분과 가족 분들의 건강을 기원합니다.

감사합니다.